

TIGERεLEC

High-Density Multilayer & Fine Pitch

The Leader of High performance Semiconductor Test Board

(주) 타이거일렉

2025 Investor Relations

www.tigerelec.com





Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 (주)타이거일렉(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다. 본 presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

Table of Contents

01 회사소개

- 1-1 회사 개요
- 1-2 Business
- 1-3 Products

02 상반기 실적

- 2-1. Customer
- 2-2. 매출구성
- 2-3. 상반기 실적현황

03 향후 전망

- 3-1. 시장 전망
- 3-2. 당사 동향

04 요약 재무정보

- 4-1. 요약 재무정보(별도)

TIGERLEC

High-Density Multilayer & Fine Pitch

The Leader of High performance

Semiconductor Test Board



01. 회사소개

- 1-1. 회사개요
- 1-2. Business
- 1-3. Products

The Leader of High Performance
Semiconductor Test Board

1-1 회사 개요

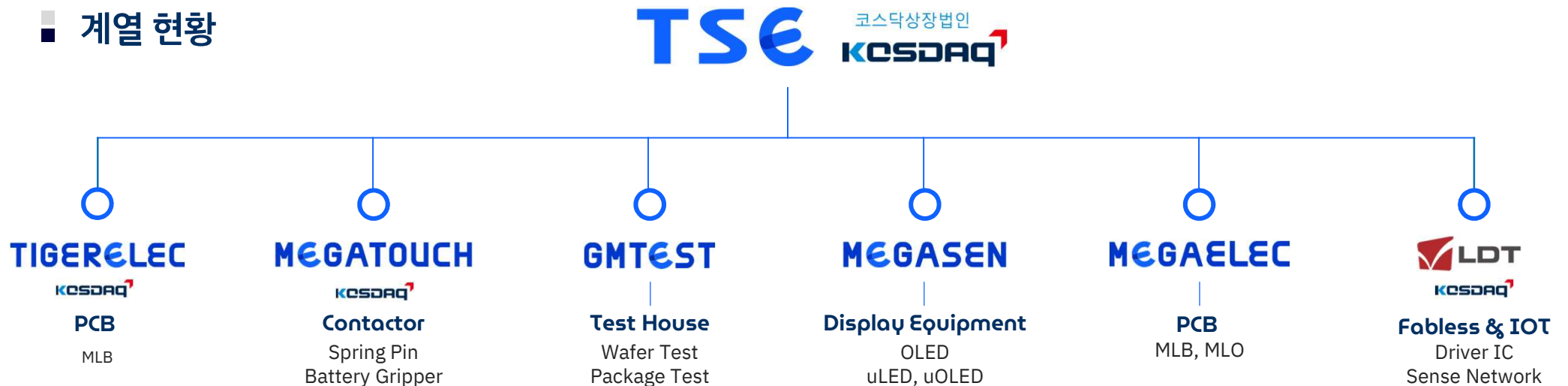
TIGERLEC

■ 기업 현황

회 사 명	(주) 타이거일렉
대표이사	허 재 정
설 립 일	2000년 7월 28일
자 본 금	31.6억원
사업영역	PCB 제조, 개발
소 재 지	인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33 (도화동)



■ 계열 현황



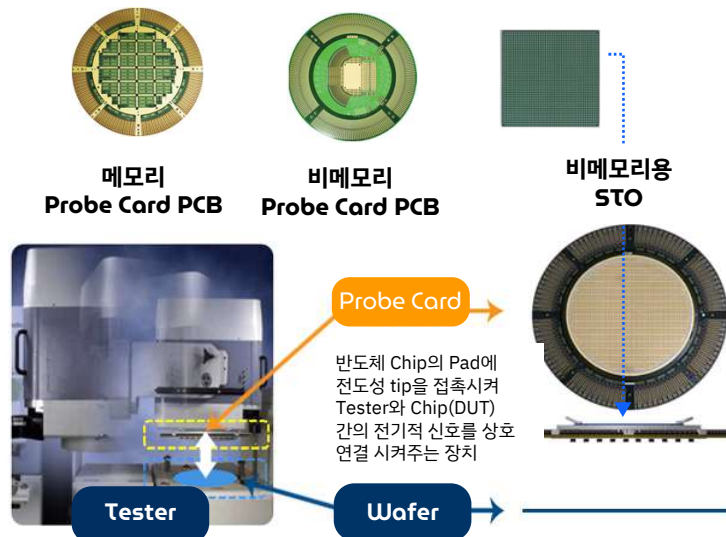
1-2. Business

■ 반도체 후공정 TEST용 PCB

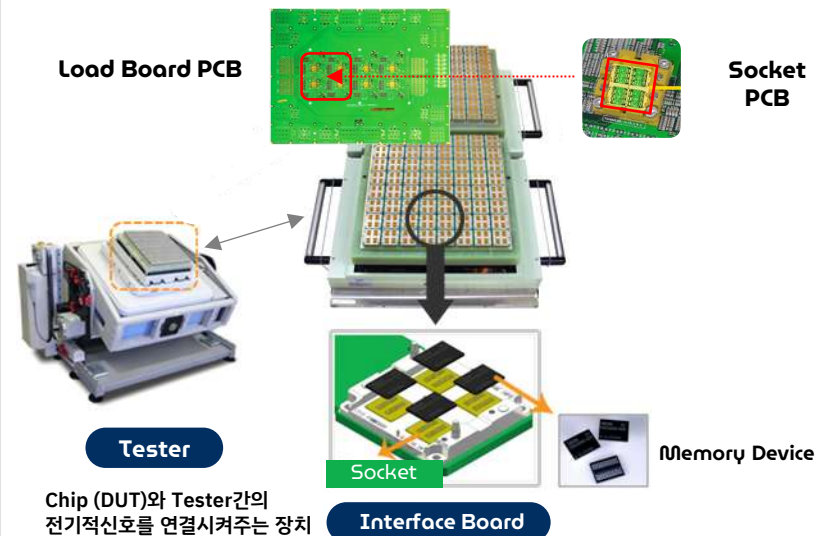
후공정 (Back-End)



Probe Card PCB , STO (비메모리용)



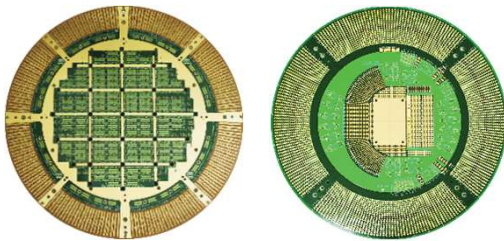
Load Board PCB , Socket PCB



1-3. Products

■ 초고다층 (High-Density Multilayer) & 고밀도 (Fine Pitch) PCB

Probe Card PCB



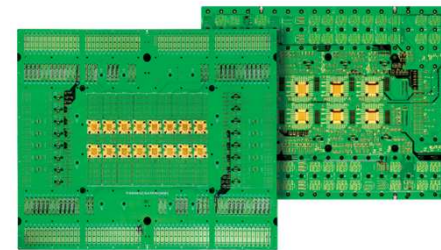
- Wafer Test 공정에서 Tester와 Device(Chip)간의 전기적 Interface를 목적으로 사용되는 Board
- 초고다층의 배선 및 각 배선상에 최적의 임피던스를 적용하여 설계

Socket Board PCB

- Package Test 공정에서 Tester와 Device간의 전기적 Interface를 목적으로 사용되는 Board
- Load Board와 결합하여 한번에 다수의 반도체제품 테스트 가능



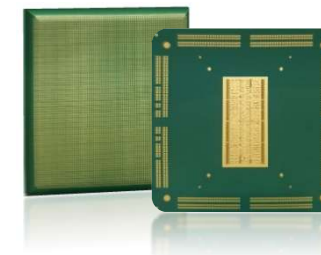
Load Board PCB



- Package Test 공정에서 Tester와 Device간의 전기적 Interface를 목적으로 사용되는 Board

STO (Space Transformer Organic)

- CPU, QPU, 등 초고속 반도체 검사용 Probe Card 및 Test Interface Board에 필요한 초미세 Pitch 기판
- Probe Card 내에서 신호를 변환하고 분배하는 기능





The Leader of High Performance
Semiconductor Test Board

02. 상반기 실적

2-1. Customer

2-2. 매출현황

2-3. 상반기 실적현황

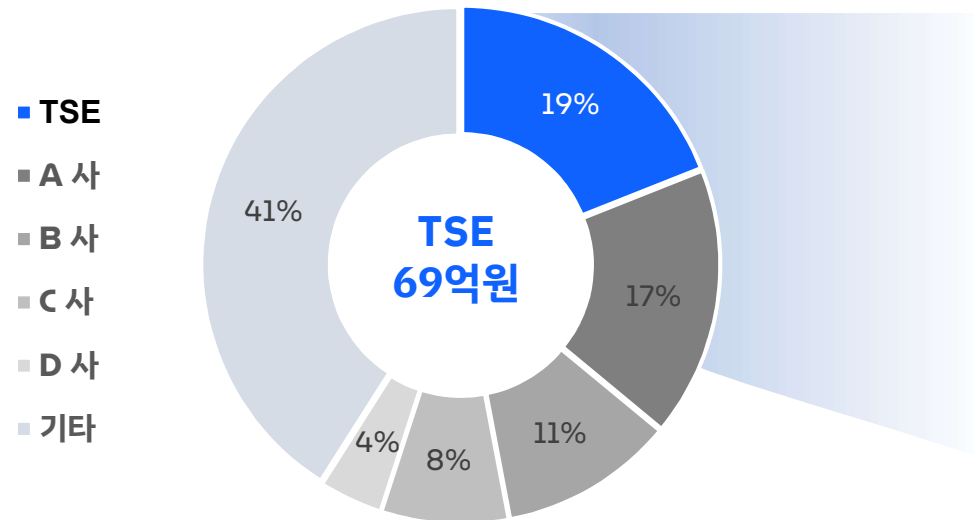
2-1. Customer

TIGERLEC

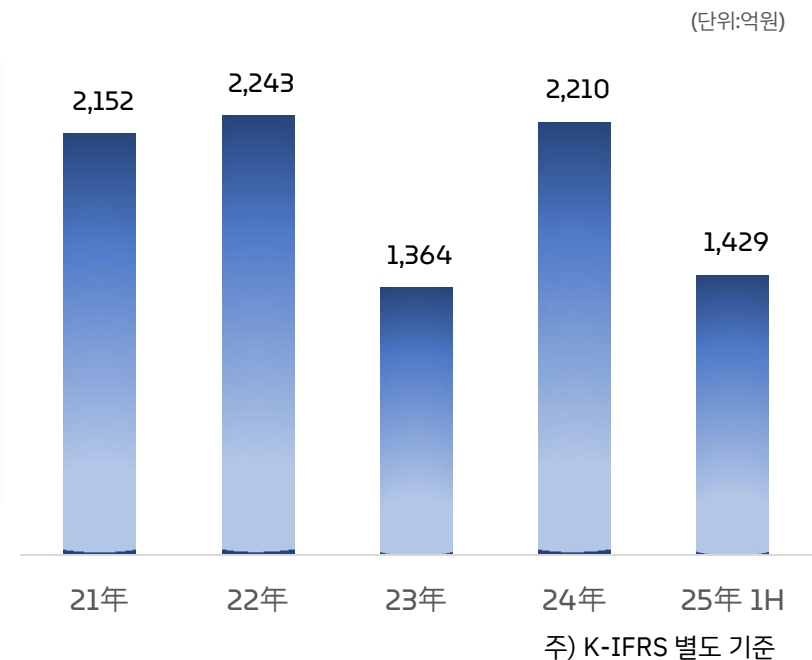
■ 매출 구조



■ 상반기 고객사별 매출비중



■ TSE 매출액 추이

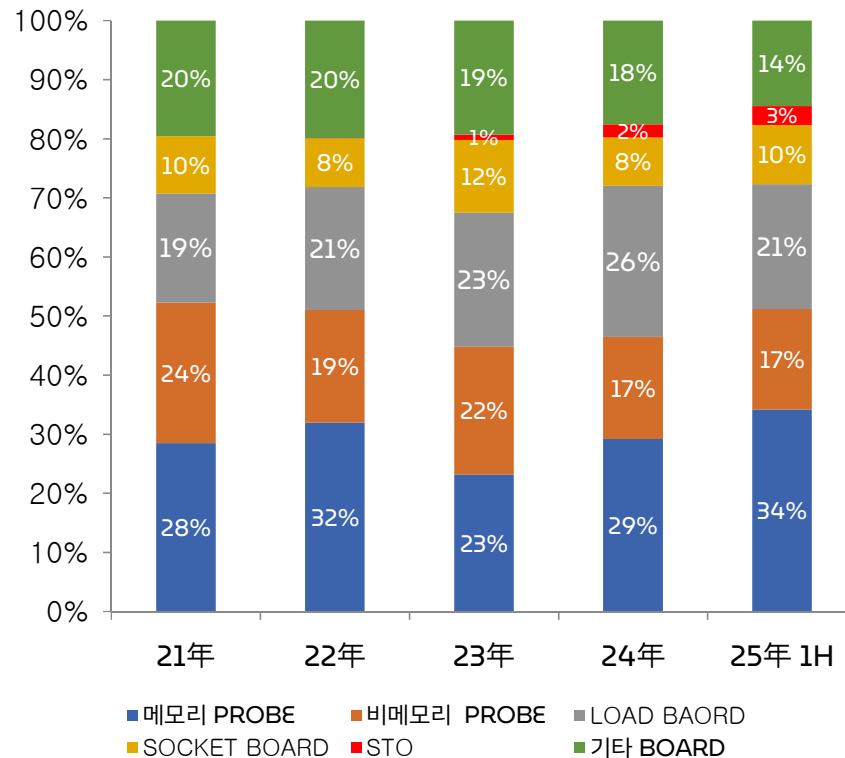


2-2. 매출구성

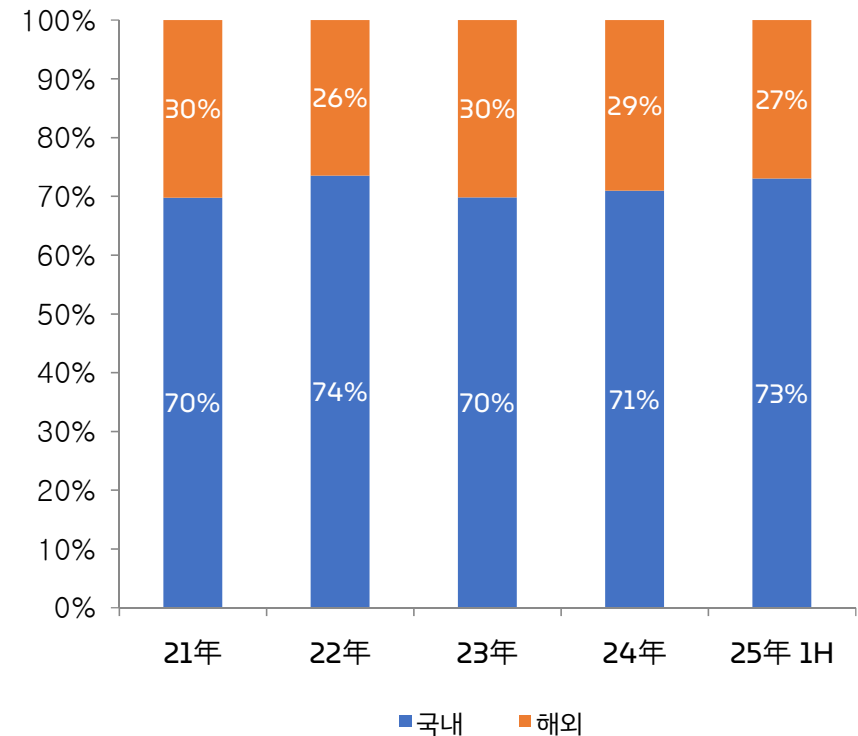
- **제품매출 비중** : Memory Probe Card PCB는 24년 상반기 매출액 대비 62% 증가한 124억원의 매출실적을 실현하였으며, 당사의 신제품인 STO는 24년 상반기 매출액 대비 99% 성장하여 12억원을 실현했습니다.

- **해외매출 비율** : 수출매출액의 비중은 전체 매출대비 2% 감소하였으나, 지난 상반기 대비 17% 증가한 98억원의 매출을 실현하였습니다.

연도별 제품매출 비중

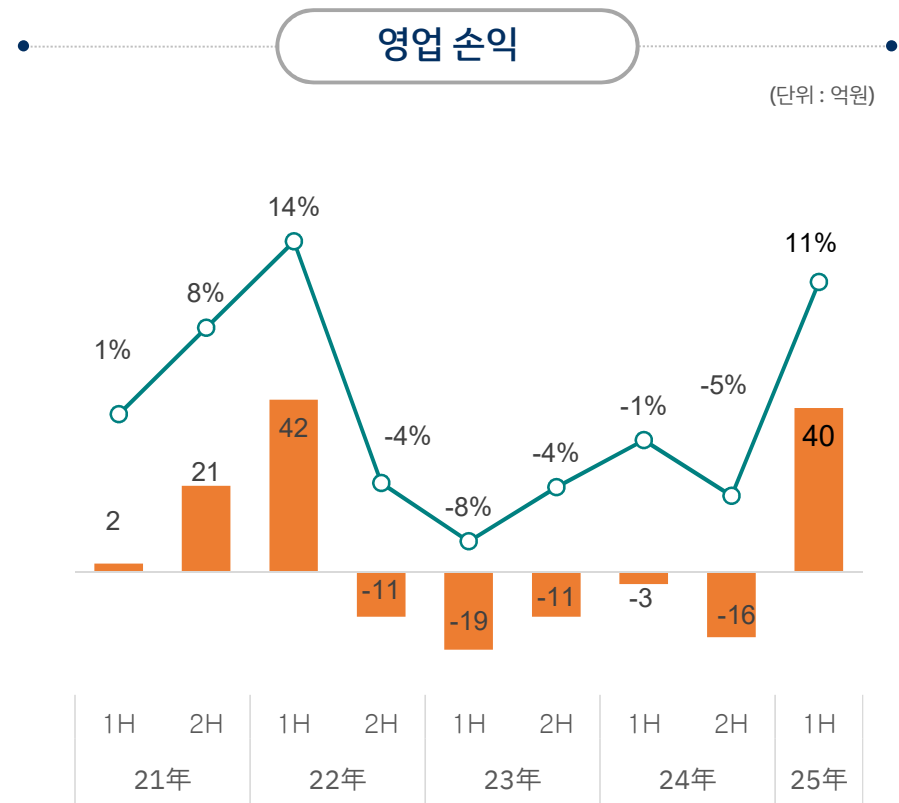
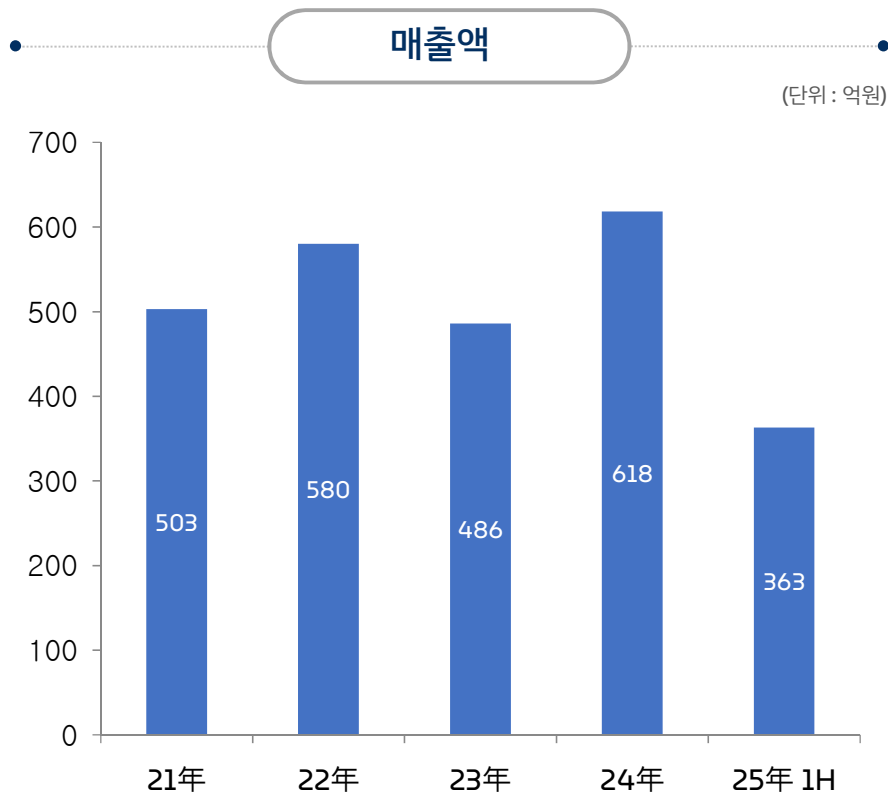


연도별 해외매출 비중



2-3. 상반기 실적현황

- **매출액**: 2022년 하반기 반도체 업계 불황을 원인으로 23년 전체 매출이 전년대비 16% 하락하였으나 24년부터 반도체 업황이 회복되어 23년 대비 27% 성장하였으며, 25년 상반기에는 24년 상반기 (289억원) 대비 25%, 24년 하반기 (329억원) 대비 10% 성장하여 회사 설립 이래 반기 최대 매출 달성하였습니다. 특히 Memory Probe Card PCB의 매출이 24년 상반기 대비 48억원 증가하였으며, 특히 Memory Probe Card PCB 제품군 중 DRAM Probe Card PCB 제품의 매출액은 8억원에서 24억원으로 증가하였습니다.
- **영업손익**: 2022년 하반기부터 적자전환 되었으며, 24년 최대매출을 달성했음에도 불구하고 제품사양이 높아지면서 수율 불안정 등을 원인으로 적자지속 상태였으나, 25년 3월 이후 불안정했던 수율이 장비투자, 인력개발등을 통해 점차 개선되어 당반기에 흑자전환 하게 되었습니다.





The Leader of High Performance
Semiconductor Test Board

03. 향후 전망

3-1. 시장 전망

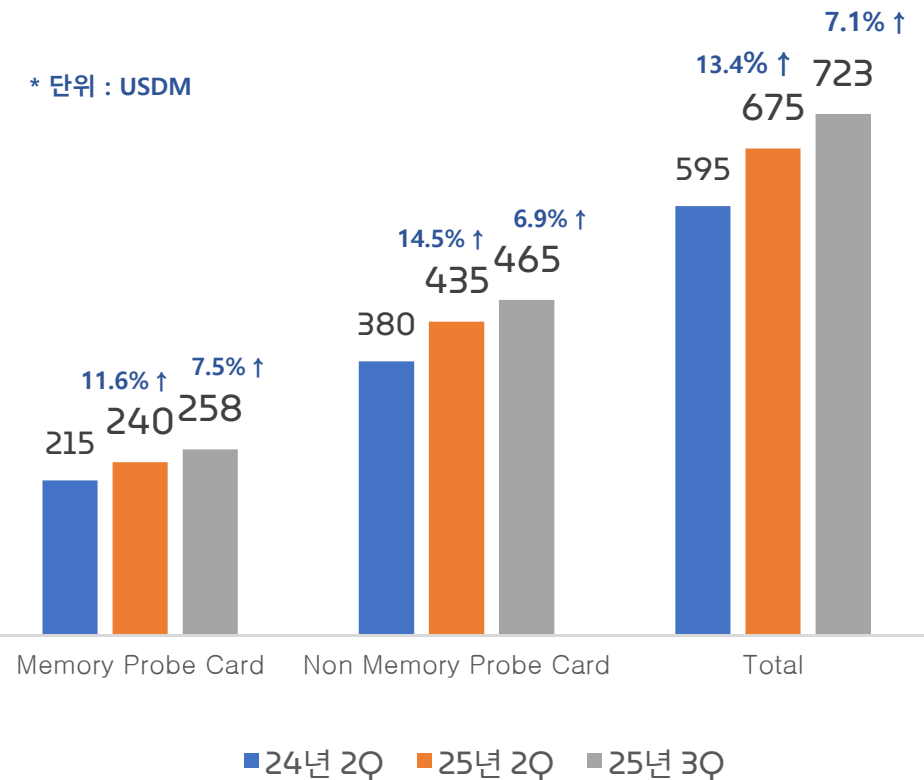
3-2. 당사 동향

3-1. 시장 전망

■ 25년 3Q이후 주요 고객사의 AI 제품 양산 본격화로 시장규모 확대 기대

Probe Card Market

* 단위 : USDM



출처: yole

Memory Market

- 2025년 : DRAM 출하 증가 및 HBM 채택 확대
- DRAM : 서버 및 AI수요 증가로 인해 성장세 유지 예상
- NAND : 가격 하락 마무리되며, 소폭 성장 예상

Non Memory Market

- 2025년 : AI 및 HPC 관련 ASIC 제품의 검증 수요 확대로
평가용 보드 수요 증가
- 3Q이후 전망 : 팹리스 AI 고객사 양산 본격화
- High-pin count probe card 와 고사양 Load board 수요 급증 예상

3-2. 당사 동향

Memory Probe Card PCB

- 국내A사向
 - NAND 하반기 양산물량 수주 예정
- 국내B사向
 - 국내C사 : HBM4 Qual 검증 中

Non Memory Probe Card PCB

- 국내A사向
 - 모바일용 AP보드 수주
 - 모바일용 차세대 AP보드 조기개발 참여 예정
 - AI 반도체칩용 테스트 보드개발 참여 中
- 해외B사 (해외C사向, D사向, E사向)
 - 글로벌 시장 확대로 최대물량 수주 기대
 - 신규 개발 프로젝트 40~50종 참여 예정

Load Board PCB

- 미국向
 - A사, B사 AI칩용 인터페이스보드 양산물량 수주
- 중화권
 - 해외A사 : 신규 자재를 통한 Hi-speed 제품 개발 中
 - 해외B사 : 중국C사向 신규 프로젝트 Qual 검증 中

STO (Space Transformer Organic)

- 해외A사
 - 미국 C사向 수주
- 해외B사
 - 중국 D사向 Qual 통과 예상
- 일본 E사, F사
 - 2Q Qual 통과 / 하반기 정식 수주 예상

- 3. 사업 경쟁력

TIGER**LEC**

Q&A

The Leader of High Performance
Semiconductor Test Board



요약 재무 정보

4-1. 요약 재무정보(별도)

The Leader of High Performance
Semiconductor Test Board

4-1. 요약 재무정보(별도)

재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.1H
유동자산	29,747	34,514	26,126	33,333	44,631
비유동자산	41,322	38,155	45,025	43,777	37,730
자산총계	71,069	72,670	71,151	77,110	82,362
유동부채	17,683	15,186	16,099	21,381	21,159
비유동부채	1,872	2,038	2,249	2,767	6,176
부채총계	19,554	17,224	18,348	24,148	27,335
자본금	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157
자본잉여금	11,888	11,888	11,888	11,888	11,888
이익잉여금	36,469	40,400	37,757	37,916	39,982
자본총계	51,514	55,446	52,803	52,962	55,207
자본과부채총계	71,069	72,670	71,151	77,110	82,362

손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.1H
매출액	50,318	58,072	48,570	61,822	36,252
매출원가	45,129	52,068	48,739	60,588	30,529
매출총이익	5,188	6,004	-169	1,235	5,729
판매비와 관리비	2,885	2,890	2,907	3,152	1,822
영업이익	2,304	3,114	-3,076	-1,917	3,901
기타수익	255	55	40	326	47
기타비용	33	33	92	195	144
금융수익	1,603	1,946	1,018	3,038	586
금융비용	258	691	849	789	1,731
법인세비용 차감전순이익	717	801	402	462	2,658
당기순이익	3,155	3,590	-2,558	275	2,065